精选快讯　硬件快讯　2026年11月12日 10:27

高通称Dragonfly AI250芯片通过硬件验证，计划2027年上半年提供样品

要点

- 高通宣布其第一代高带宽计算（HBC）硅片在圣地亚哥实验室通过硬件验证。
- 高通声称Dragonfly AI250的有效内存带宽最高可达LPDDR的18倍，每瓦带宽比HBM4高出5倍以上。
- 高通计划于2027年上半年提供Dragonfly AI250样品，并计划于2028年提供后续Dragonfly AI300平台样品。

高通宣布其第一代高带宽计算（HBC）硅片在圣地亚哥实验室通过硬件验证。公司表示，一款数据中心产品已完成流片，且逻辑基底与键合DRAM层级的早期启动正在产出。

高通声称Dragonfly AI250的有效内存带宽最高可达LPDDR的18倍，每瓦带宽比HBM4高出5倍以上。该HBC设计采用标准有机基板，而非HBM加速器所需的硅中介层和桥接。

高通计划于2027年上半年提供Dragonfly AI250样品，并计划于2028年提供后续Dragonfly AI300平台样品。目前，高通未公布Dragonfly AI250的价格、出货日期或生产配置。

报道来源：shattered

来源网站：https://www.inews.today/